

ASH.010

Claims 1-6 and 10-14

Reason 2

Coating a resin used to prevent shorting in the slits of an elastic film connection substrate is nothing more than commonly known and applied technology in the technology sector (concerning this point, reference is made to protective films 19 and 29 referred to in Japanese Laid Open Patent Publication Hei 11-102938, and solder resists 6, 7, 30, 31, 111 and 112 referred to in Japanese Laid Open Patent Publication Hei 11-121682).

One skilled in the Art could easily obtain the attachment of resin used to prevent short circuiting in a slit from the inventions recorded in Citations 1-3.

Claims 7 and 15

Reason 2

The applicant, in the Opinion document, asserts that there is a difference in comparison with the "dummy pattern" referred to in Citation 3 in the point relating to the attachment location, shape and construction method of the "rib" relating to the invention of the present application. However, since this is not an assertion based upon the notations in the claims, the assertion cannot be adopted. Since the "dummy pattern" recorded in Citation 3 is also a reinforcement member (used to improve bending strength) attached so as to face the film, there is no recognized difference between the terms "rib" and "dummy payment".

(New reason for rejection not included in the Grounds for Rejection Notice)

Claims 8 and 9

Reason 2

As a reference publication, in the CD-ROM relating to the cited Utility Model application Hei 04-044248 (Japanese Laid Open Utility Model Publication Hei 06-007242), reference is made to attaching a fold processor 4 to the TAB, accomplished

at the same time as press processing at the time of removing the metallic mold for the TAB base member.

The fold processor corresponds to the reinforcement rib of the invention of the present application. Forming a fold processor at the time of removal processing (in other words, at the time of cut separation), could be easily obtained by one skilled in the Art from the inventions recorded in Citations 1-3.

## 拒絶査定

特許出願の番号 特願2000-044203  
 起案日 平成16年 1月 7日  
 特許庁審査官 池渕 立 8831 4R00  
 発明の名称 テープキャリア型半導体装置および可撓性フィルム接続基板  
 特許出願人 NEC液晶テクノロジー株式会社  
 代理人 岩佐 義幸

この出願については、平成14年11月27日付け拒絶理由通知書に記載した理由2によって、拒絶をすべきものである。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

## 備考

請求項1～6、10～14について：理由2

可撓性フィルム接続基板のスリットに断線防止用樹脂を塗布することは当該技術分野の周知・慣用の技術にすぎない（この点については、特開平11-102938号公報に記載された保護膜19、29、特開平11-121682号公報に記載されたソルダレジスト6、7、30、31、111、112を参照のこと）。

引用文献1～3に記載された発明において、スリット部に断線防止用樹脂を設けることは当業者が容易になし得たことである。

請求項7、15について：理由2

出願人は意見書において、本願発明の「リブ」はその設けられる箇所、形状、製造方法の点で引用文献3に記載の「ダミーパターン」と相違すると主張しているが、請求項の記載に基づく主張ではないため上記主張は採用できない。引用文献3に記載された「ダミーパターン」もフィルムの対向する辺に沿って設けられた補強用（屈曲強度を向上させるため）の部材であるので、「リブ」と「ダミーパターン」は文言上相違するものとは認められない。

（拒絶理由通知で通知されなかった新たな拒絶理由）

請求項8、9について：理由2

参考文献として引用した実願平04-044248号（実開平06-007242号）のCD-ROMには、TAB基材の金型打ち抜き時にプレス加工と同時

整理番号:74610436 発送番号:005974 発送日:平成16年 1月13日 2/E

行える折り曲げ加工部4をT A Bに設けることが記載されている。上記折り曲げ加工部は本願発明の補強用リブに相当している。引用文献1～3に記載の発明において、フィルムの補強のために打ち抜き加工時(即ち切り離し時)に折り曲げ加工部を形成するようにすることは当業者が容易になし得たことである。)

---

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成16年 1月 8日 経済産業事務官 栗田 健志